PCB 전자회로 산업전 4월 23-25일 개최

지식경제부는 PCB 전시회인 <국제 전자회로 산업전(KPCA Show 2008)>을 4월 23-25일 COEX 태평양 및 인도양 홀에서 개최한다.

국제 전자회로 산업전은 33개국 374개의 PCB 관련기업들이 첨단 PCB 및 관련 재료·장비 등 세계 최고의 상품 및 기술을 놓고 경쟁하는 전시회로 세계 PCB 생산을 주도하고 있는 일본(JPCA), 중국(CPCA), 타이완(TPCA), 홍콩(HKPCA)등 해외 PCB협회 회장들이 참석할 예정이다.

전시회에서는 한국PCB산업대상인 국무총리상을 받은 삼성전기가 세계에서 가장 얇은 반도체패키지용 기판인 UTCSP(Ultra Thin Chip Scale Package)를 출품하며, 한국PCB기술대상인 지식경제부장관상을 받은 SKC가 국내 최초로 개발한 Polyimide Film, 세호로보트산업은 커버레이 자동가접기, 그리고 JIT는 가이드홀 펀칭기 등을 전시한다.

LG전자는 세계적 수준의 SiP(System in Package) 및 BOC(Board on Chip)를 출품하며, 세계적 기업인 Atotech, R&H, Macdermid에서 PCB 제조관련 약품과 이스라엘 Orbotech은 레이저회로투사기(LDI: Laser Direct Imaging), 자동광학검사기(AOI: Automated Optical Inspection) 등 PCB 검사장비를 소개한다.

특히, 전시회에서는 지식경제부가 매년 선정하는 세계 일류상품 중 PCB와 관련된 세계일류 상품관이 운영되는데, 대덕전자의 Build-up 기판, 대덕GDS의 실버스루홀기판, 삼성전기의 CSP 및 0.4mm Pitch SAVIA, 두산전자의 페이퍼페놀 동박적층판, 일진소재산업의 전해동박, 네오티스의 라우터 비트 및 이오테크닉스의 레이저마커 등이 소개될 예정이다.

<화학저널 2008/04/22>

Copyright ⓒ 2003 by CMRI 화학경제연구원